

Primo1D

The E-Thread® Company



Créée en 2013, la startup s'est hissée au rang de leader mondial du fil électronique intelligent grâce à sa technologie E-Thread™, intégrée à la source dans les produits de ses clients. En proposant une solution unique d'identification (RFID UHF), d'authentification et de traçabilité des produits tout au long de leur cycle de vie, Primo1D répond à l'enjeu de la digitalisation, aux besoins croissants relatifs à l'industrie 4.0 ainsi qu'aux défis actuels de l'économie circulaire.

Suite à notre dernière levée de fonds (Nov. 2021), nous sommes en phase de croissance industrielle. Nous développons nos procédés d'assemblage et nos équipements de production pour produire en grand volume et nous accompagnons nos clients dans l'adoption de nos produits intégrés.

La mission de l'équipe de Développement Produit est de répondre aux besoins du marché grâce à la personnalisation de nos technologies et en faisant l'interface technique avec nos clients : des sociétés industrielles familiales et des multinationales du retail.

Afin d'accompagner notre développement nous recrutons un/une :

Chef.fe de Projet Développement Back-End Semiconducteur

Contexte :

Vous rejoignez l'équipe de Développement Produit pour prendre en charge le développement de nos composants silicium. Le métier consiste à améliorer nos procédés silicium pour produire des wafers E-Thread™ nécessaires à la fabrication de nos composants RFID. L'objectif sera de stabiliser les procédés sur une ligne pilote en cours de construction pour les amener à maturité dans un environnement de production.

Vous menez cette mission en partenariat étroit avec un centre R&T asiatique (Taïwan) et des sociétés industrielles en France et à l'étranger (équipementiers, fournisseurs de puces).

Pour apporter de la diversité à vos missions, vous pourrez également participer au développement des nouveaux produits, en interne et en interface avec nos clients.

Activités :

- Vous êtes en charge des relations et les projets avec nos fournisseurs et nos partenaires technologiques pour la fabrication de nos wafers.
- Vous développez les moyens d'analyse et de caractérisation des wafers et des composants électroniques et en assurez la mise en œuvre en collaboration avec nos partenaires.
- Vous proposez des améliorations de procédés pour optimiser les rendements et la qualité.
- Vous accompagnez l'équipe de production dans l'utilisation des wafers.
- A moyen terme, vous contribuez au déploiement en production de nos wafers avec un OSAT.
- Vous apprenez à connaître l'univers RFID, et en particulier les puces disponibles sur le marché.
- Vous participez au développement des nouveaux produits et participez aux analyses de défaillance des produits.



Profil recherché :

De formation Ingénieur.e avec une première expérience dans le semiconducteur en tant qu'ingénieur.e procédés ou ingénieur.e filière / intégration, vous avez une bonne connaissance des différentes étapes technologiques (photo, dépôt, gravure, électrolyse, dépôt métal,..) et des techniques de caractérisation (microscopie électronique, EDX, métallographie).

Vos capacités relationnelles vous permettent de développer des partenariats de qualité en France et à l'international (Anglais B2 indispensable).

Vos qualités de rigueur, d'analyse et de synthèse, seront autant d'atouts dans la réalisation de vos missions en mode projet.

Poste en **CDI**, basé au siège à **Grenoble** (présentiel)

Rémunération en fonction de votre expérience.

Avantages : mutuelle, plan d'intéressement, restaurant d'entreprise, locaux récents et bien desservis (proximité tram et train).

Vous avez une appétence pour les technologies nouvelles ? Vous souhaitez contribuer aux enjeux sociétaux et industriels d'aujourd'hui et de demain ? Ce poste est fait pour vous !

Rejoignez une équipe de 25 talents jeunes, motivés et attachés à l'épanouissement professionnel.

Envoyez-nous votre candidature (CV+LM) à : contact@primo1d.com